

Niederdruck-Plasmaanlage V10-G

Leistungsfähiges Batch-System zur Entfernung von Fotolack

Die Batch-Anlage V10-G ist sowohl für die industrielle Fertigung als auch für den Laborbereich in Forschung und Entwicklung geeignet. Eine vollwertige SPS-Steuerung dient zur Speicherung von voreinstellbaren Prozessen mit unterschiedlichen Parametern.

Anwendungsmöglichkeiten

- Entfernung von Fotolackschichten (auch SU-8) nach Trockenprozessen wie RIE, Elektronenstrahlätzen, Ionenstrahlätzen, sowie nach High-Dose-Implantation
- Waferreinigung
- Verbesserung der Benetzbarkeit von Siliziumwafern und anderen Substraten vor Nassprozessen
- Einsatz in der MEMS- und Nanotechnologie
- Entfernung von Polymerrückständen nach dem Bosch-Prozess
- Entfernung organischer Opferschichten
- Konditionierung bioaktiver Schichtaufbauten



Systemeigenschaften

- Prozesskammer: Quarzglaszylinder
- Türauszug
- Grafische Anzeige aller prozessrelevanten Parameter
- Archivierung aller Prozesse
- Fernwartung (VPN)
- Ethernet-Schnittstelle

Optionen

- Vakuumpumpe (extern)
- Ozonfalle
- Bis zu zwei weitere Gaseinlässe
- Soft-Start und Slow-Vent
- Faraday-Käfig
- Prozessdruck-Regelventil
- Sauerstoffkonzentrator
- Untergestell



Die Niederdruck-Plasmaanlage V10-G ist mit einer Schiebetür und einer Prozesskammer aus Quarzglas ausgestattet und kann auch für die Reinigung von Wafern eingesetzt werden.

Technische Daten

Anlagenabmessungen (B x T x H)	720 x 820 x 820 mm
Kammerabmessungen (Ø x T)	215 x 260 mm
Plasmaanregungsfrequenz	Mikrowelle (2,45 GHz)
Mikrowellenleistung	50-600 W
Gaseinlässe mit Mass-Flow-Controller	1 Kanal
Elektrischer Anschluss	400 V, 50 / 60 Hz
Anschlussleistung (ohne Vakuumpumpe)	1,5 kVA
Druckmessung	Pirani
Gewicht	150 kg